

#### PATENT APPLICATION

## IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re the Application of:

SUZUKI, Takanori et al.

Group Art Unit: UNKNOWN

**NEW Application** 

Examiner: UNKNOWN

Filed: April 11, 2001

Attorney Dkt. No.: 107348-00097

For: HYDROGEN STORAGE TANK

## **CLAIM FOR PRIORITY**

Commissioner for Patents Washington, D.C. 20231

April 11, 2001

Sir:

The benefit of the filing date of the following prior foreign applications filed in the following foreign country is hereby requested for the above-identified patent application and the priority provided in 35 U.S.C. §119 is hereby claimed:

> Japanese Patent Application Nos. 2000-115822 and 2000-115823 filed on April 11, 2000 in Japan

In support of this claim, certified copies of said original foreign applications are filed herewith.

It is requested that the file of this application be marked to indicate that the requirements of 35 U.S.C. §119 have been fulfilled and that the Patent and Trademark Office kindly acknowledge receipt of these documents.

Please charge any fee deficiency or credit any overpayment with respect to this paper to Deposit Account No. 01-2300.

Respectfully submitted,

Customer No. 004372 ARENT FOX KINTNER PLOTKIN & KAHN, PLLC 1050 Connecticut Avenue, N.W., Suite 600 Washington, D.C. 20036-5339

Tel: (202) 857-6000

Fax: (202) 638-4810

MO/cvi



## PATENT OFFICE JAPANESE GOVERNMENT

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

Date of Application:

April 11, 2000

Application Number:

Patent Application No. 2000-115822

Applicant(s):

HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA

November 10, 2000

Commissioner, Patent Office

Kozo Oikawa

Certificate No. 2000-3094413

# 日本国特許庁

PATENT OFFICE JAPANESE GOVERNMENT



別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

2000年 4月11日

出 願 番 号 Application Number:

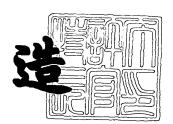
特願2000-115822

出 願 人 Applicant (s):

本田技研工業株式会社

2000年11月10日

特許庁長官 Commissioner, Patent Office 及川耕



【書類名】

特許願

【整理番号】

H100078901

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

F17B 1/00

【発明者】

【住所又は居所】

埼玉県和光市中央1丁目4番1号 株式会社本田技術研

究所内

【氏名】

鈴木 貴紀

【発明者】

【住所又は居所】

埼玉県和光市中央1丁目4番1号 株式会社本田技術研

究所内

【氏名】

鹿屋 出

【発明者】

【住所又は居所】

埼玉県和光市中央1丁目4番1号 株式会社本田技術研

究所内

【氏名】

細江 光矢

【特許出願人】

【識別番号】

000005326

【氏名又は名称】 本田技研工業株式会社

【代表者】

吉野 浩行

【代理人】

【識別番号】

100071870

【弁理士】

【氏名又は名称】

落合 健

【選任した代理人】

【識別番号】

100097618

【弁理士】

【氏名又は名称】 仁木 一明

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 003001

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 水素貯蔵タンク

【特許請求の範囲】

【請求項1】 外筒体(2)と、その外筒体(2)内周面との間に水素通路(3)となる間隔を存してその外筒体(2)内に収容された少なくとも1つの筒状水素貯蔵モジュール(4)とを備え、前記筒状水素貯蔵モジュール(4)は、水素貯蔵材(HSM)を充填されて外周面の少なくとも一部を水素吸蔵放出面(6)とした複数の水素貯蔵ユニット(7)を、相隣る両ユニット(7)間に加熱一冷却体(8)を介在させて積層した積層体(5)と、その積層体(5)をユニット積層方向に貫通して加熱用流体および冷却用流体を流通させる少なくとも1つの主通路(9,10)と、その主通路(9,10)から分岐して、各加熱一冷却体(8)内に延びる副通路(11,12)とを有することを特徴とする水素貯蔵タンク。

【請求項2】 前記副通路(11,12)に,前記加熱用流体および冷却用流体をその副通路(11,12)全体に行き渡らせるガイド部材(43~47;48~52)を配設した,請求項1記載の水素貯蔵タンク。

【請求項3】 前記加熱用流体は燃焼用水素と酸素であり、前記加熱-冷却体(8)は燃焼用水素と酸素との燃焼反応を促進する触媒を有する、請求項1または2記載の水素貯蔵タンク。

【請求項4】 前記主通路は、燃焼用水素を流通させる第1主通路(9)と酸素を流通させる第2主通路(10)とを有し、前記副通路は、前記触媒を保持する通気性担体(37)を挟む一側に在って前記第1主通路(9)に連通する第1副通路(11)と、他側に在って前記第2主通路(10)に連通する第2副通路(12)とを有し、前記筒状水素貯蔵モジュール(4)は前記第2副通路(12)に連通する流出路(42)を有する、請求項1、2または3記載の水素貯蔵タンク。

【請求項5】 各水素貯蔵ユニット(7)は、粉末状水素貯蔵材(HSM)内に押込まれて前記加熱-冷却体(8)に接触する複数のフィン(62)を有する、請求項1,2,3または4記載の水素貯蔵タンク。

## 【発明の詳細な説明】

[0001]

## 【発明の属する技術分野】

本発明は、水素を吸蔵し、またその水素を放出する水素貯蔵タンクに関する。 【0002】

#### 【従来の技術】

従来、この種の水素貯蔵タンクとしては、例えば、二重円筒型タンクが知られている。このタンクは、内筒内に水素貯蔵合金を収容すると共にその軸線回りに吸蔵用水素および放出水素を流通させる水素通路を設け、内、外筒間を加熱用流体および冷却用流体の通路としたものである。

#### [0003]

#### 【発明が解決しようとする課題】

しかしながら従来のタンクは、水素通路が細いことに起因して単位容積当りの 水素吸蔵放出面積が小さいため、単位容積当りの水素吸蔵量が少なく、また加熱 効率が悪いため水素の放出速度が遅い、という問題があった。

## [0004]

#### 【課題を解決するための手段】

本発明は、単位容積当りの水素吸蔵放出面積を大にして単位容積当りの水素吸蔵量を増加し、また水素の放出を迅速に行い得るようにした前記水素貯蔵タンクを提供することを目的とする。

#### [0005]

前記目的を達成するため本発明によれば、外筒体と、その外筒体内周面との間に水素通路となる間隔を存してその外筒体内に収容された少なくとも1つの筒状水素貯蔵モジュールとを備え、前記筒状水素貯蔵モジュールは、水素貯蔵材を充填されて外周面の少なくとも一部を水素吸蔵放出面とした複数の水素貯蔵ユニットを、相隣る両ユニット間に加熱ー冷却体を介在させて積層した積層体と、その積層体をユニット積層方向に貫通して加熱用流体および冷却用流体を流通させる少なくとも1つの主通路と、その主通路から分岐して、各加熱ー冷却体内に延びる副通路とを有する、水素貯蔵タンクが提供される。

## [0006]

前記のように構成すると、水素吸蔵放出面は各水素貯蔵ユニットの外周面に在り、またその回りを水素通路が囲んでいるので、単位容積当りの水素吸蔵放出面積を大にすることが可能であり、これにより単位容積当りの水素吸蔵量を増加させることができる。さらに各水素貯蔵ユニットを広い伝熱面積を有する各加熱ー冷却体により効率良く冷却し、これにより水素貯蔵材における蓄熱を回避して水素吸蔵効率を向上させると共に水素吸蔵量を増加させることができる。

## [0007]

一方,水素放出時には,各水素貯蔵ユニットの水素貯蔵材を各加熱 - 冷却体により効率良く加熱して,水素の放出を広い水素吸蔵放出面より迅速に行うことができる。

## [0008]

さらにまた水素貯蔵ユニットの増減により、タンクの水素吸蔵量の増減を簡単 に行うことができる。その上、タンクの製造性を良好にすると共にその構造の簡 素化を図ることが可能である。

## [0009]

## 【発明の実施の形態】

図1~6は水素貯蔵タンク1の第1実施例を示し、その水素貯蔵タンク1は、ステンレス網より構成された横断面円形の耐圧性外筒体2と、その外筒体2の外周壁2a内周面との間に水素通路3となる間隔を存してその外筒体2内に収容された少なくとも1つ、実施例で1つの円筒状水素貯蔵モジュール4とを備えている。円筒状水素貯蔵モジュール4は積層体5を有し、その積層体5は、粉末状水素貯蔵材HSMを充填されて外周面の少なくとも一部、実施例では外周面全体を水素吸蔵放出面6とした複数の水素貯蔵ユニット7を、相隣る両ユニット7間に加熱一冷却体8を介在させて積層したものである。水素貯蔵材HSMとしては水素貯蔵合金(例えば、Mg2 Ni等のMg合金)、ナノ構造カーボン等が用いられる。加熱一冷却体8は、必要に応じて最上位の水素貯蔵ユニット7の上面側および最下位の水素貯蔵ユニット7の下面側にもそれぞれ設けられる。

#### [0010]

また水素貯蔵モジュール4は、その積層体5をユニット積層方向に貫通して加熱用流体および冷却用流体を流通させる少なくとも1つ、実施例では第1および第2主通路9、10と、それら主通路9、10から分岐して、各加熱ー冷却体8内に延びる第1および第2副通路11、12とを有する。

#### [0011]

水素貯蔵ユニット7は、軸線回りに大径貫通孔13を有するステンレス鋼製円 筒体14を備え、その円筒体14内に粉末状水素貯蔵材HSMが充填されている 。円筒体14は、大径貫通孔13を有する中空軸15と、その中空軸15の両端 にそれぞれ一体に形成された上、下端壁16、17と、それら上、下端壁16、 17の対向外周部間に溶接等により接合されて外周壁を構成する通気性フィルタ 18とを有する。フィルタ18は、その外周面全体を水素吸蔵放出面6とすべく 、水素が出入りし得る多数の微細孔、例えば、数nm~0.1μmの孔を有する

## [0012]

図3に明示するように、上端壁16は、その外周縁に在って上方に向って延びる環状突出部19と、その突出部19の近傍に在って大径貫通孔13と一直線状に並ぶ一対の小径貫通孔20、21を有する。下端壁17はその外周縁に在って下方に向って延びる環状突出部22と、その突出部22の近傍に在って上端壁16の両小径貫通孔20、21とそれぞれ同軸上に位置する一対の小径貫通孔23、24とを有する。上、下端壁16、17の同軸上に位置する一組の両小径貫通孔20、23にステンレス鋼よりなる第1主通路用第1管体25が、またもう一組の両小径貫通孔21、24にステンレス鋼よりなる第2主通路用第2管体26がそれぞれ挿通されてそれら孔回りに溶接等によって接合される。

#### [0013]

第1管体25の下端面は下端壁17下面に合致しており、またその下部開口27は大径端を下側にした円錐台形に形成されている。また第1管体25の上端部28は、上端壁16の環状突出部19上端面よりも上方に位置し、下部開口27に合致するように大径端を下側にした円錐台形に形成されている。さらに第1管体25には一対の流入孔29が、上端壁16上面よりも僅か上方で、且つ環状突

出部19上端面よりも下方に位置するように相対向して形成される。

#### [0014]

第2管体26の下端面は下端壁17下面に合致しており、またその下部開口30は大径端を下側にした円錐台形に形成されている。また第2管体26の上端部31は、上端壁16の環状突出部19上端面よりも上方に位置し、且つ下部開口30に合致するように大径端を下側にした円錐台形に形成されている。さらに第2管体26には一対の流入孔32が、円錐台形上端部31の大径端よりも僅か下方で、且つ環状突出部19上端面よりも上方に位置するように相対向して形成される。

#### [0015]

積層体 5 においては、相隣る両水素貯蔵ユニット 7、したがって下側のユニット 7の上端壁 1 6 に存する環状突出部 1 9 と上側のユニット 7の下端壁 1 7 に存する環状突出部 2 2 の上、下端面が突き合せられて、溶接等により接合される。また下側のユニット 7 に存する第 1 管体 2 5 の円錐台形上端部 2 8 が上側のユニット 7 に存する第 1 管体 2 5 の円錐台形上端部 2 8 が上側のユニット 7 に存する第 1 管体 2 5 の円錐台形下部開口 2 7 に嵌着され、この繰返しによる複数の第 1 管体 2 5 の継ぎ合せによって、それらの内部に一連の第 1 主通路 9 が構成される。さらに下側のユニット 7 に存する第 2 管体 2 6 の円錐台形下部開口 3 0 に嵌着され、この繰返しによる複数の第 2 管体 2 6 の 円錐台形下部開口 3 0 に嵌着され、この繰返しによる複数の第 2 管体 2 6 の継ぎ合せによって、それらの内部に一連の第 2 主通路 1 0 が形成される。各水素貯蔵ユニット 7 の一連の大径貫通孔 1 3 にステンレス鋼製の大径管 3 3 が嵌着される。

#### [0016]

相隣る両水素貯蔵ユニット7間には、それらの上、下端壁16,17を上、下端壁として共用し、また突き合せられた両環状突出部19,22を外周壁34とし、さらに大径管33の一部を内周壁35とする、加熱一冷却体8のハウジング36が形成される。そのハウジング36内の環状空間において、その上、下方向中間部に、円板形をなし、且つ触媒を保持する通気性担体37が配置される。通気性担体37は、連続気孔を有する金属(例えば、Ni)多孔質体、セラミック多孔質体等よりなり、また第1、第2管体25、26および大径管33と嵌合す

る2つの小径貫通孔38,39および大径貫通孔40を有し,さらに外周面は外周壁34内周面に密着するもので,この通気性担体37によってハウジング36内は上,下に二分割される。下側の空間には第1管体25の両流入孔29が連通しており,その下側の空間は第1主通路9から分岐する第1副通路11として機能する。一方,上側の空間には第2管体26の両流入孔32が連通しており,その上側の空間は第2主通路10から分岐する第2副通路12として機能する。その第2副通路12は大径管33の一部である内周壁35に形成された流出孔41を介して大径管33内の流出路42に連通する。

#### [0017]

図2,3に明示するように,第1副通路11を維持すべく,通気性担体37および上端壁16間には,ステンレス鋼,Ni等の金属,セラミックス等からなる複数のスペーサが配設される。即ち,上端壁16の外周部には環状スペーサ43が,また第1管体25回りには両流入孔29の開口を閉じないように一対の円弧状スペーサ44が,さらに第2管体26および大径管33回りには環状スペーサ45,46が,さらにまた大径管33を挟むように,両端を第1,第2管体25,26近傍にそれぞれ位置させた一対の円弧状スペーサ47がそれぞれ配設されている。

#### [0018]

これらスペーサ43~47は,流入孔29から第1副通路11に流入した加熱 用流体および冷却用流体を第1副通路11全体に行き渡らせるガイド部材として の機能も有する。例えば,図3に矢印で示すように,流入孔29からの加熱用流 体等は,環状スペーサ43および円弧状スペーサ47間に導かれ,次いで環状スペーサ45に衝突し,その後円弧状スペーサ47および環状スペーサ46間に導 かれ,さらに円弧状スペーサ44に衝突する,といったようにガイドされる。

## [0019]

図2,5に明示するように,第2副通路12を維持すべく,通気性担体37および下端壁17間には,前記と同材種の複数のスペーサが配設される。即ち,通気性担体37の外周部には環状スペーサ48が,また第2管体26回りには両流入孔32の開口を閉じないように一対の円弧状スペーサ49が,さらに第1管体

25回りには環状スペーサ50が、さらにまた大径管33回りには流出孔41を 閉じないようにC字状スペーサ51が、また大径管33を挟むように、両端を第 1、第2管体25、26近傍にそれぞれ位置させた一対の円弧状スペーサ52が それぞれ配設されている。

### [0020]

これらスペーサ48~52は,流入孔32から第2副通路12に流入した加熱 用流体および冷却用流体を第2副通路12全体に行き渡らせるガイド部材として の機能も有する。例えば,図5に矢印で示すように,流入孔32からの加熱用流 体等は,環状スペーサ48および円弧状スペーサ52間に導かれ,次いで環状スペーサ50に衝突し,その後円弧状スペーサ52およびC字状スペーサ51間に 導かれ,さらに円弧状スペーサ49に衝突する,といったようにガイドされる。

#### [0021]

加熱用流体は燃焼用水素と酸素であり、第1主通路9は燃焼用水素を、また第2主通路10は酸素、実施例では空気をそれぞれ流通させる。また加熱-冷却体8の通気性担体37は、燃焼用水素と酸素との燃焼反応を促進する触媒として白金、パラジウム等を担持する。

#### [0022]

冷却用流体としては冷却用ガス、例えば空気が用いられる。この冷却用流体は 第1,第2主通路9,10,第1,第2副通路11,12および排出路42を流 通する。

#### [0023]

図1に明示するように、外筒体2の上端壁53には第1、第2管体25,26 および大径管33の上端部ならびに水素通路3の上部に連通する第1~第4接続 管54~57が保持される。一方、外筒体2の下端壁58には第1、第2管体2 5、26および大径管33の下端部に連通する第5~第7接続管59~61が保 持される。

#### [0024]

次に,水素貯蔵タンク1における水素の吸蔵および水素の放出について説明する。

## [0025]

水素吸蔵時には、図2に示すように水素を第4接続管57から水素通路3に導入する。水素は各水素貯蔵ユニット7のフィルタ18全周においてそのフィルタ18を通過して粉末状水素貯蔵材HSMに吸蔵される。

#### [0026]

冷却用空気は、第5、第6接続管59、60を介し第1、第2主通路9、10の下端側から供給されてそれら主通路9、10を流通する。その際、冷却用空気は第1、第2管体25、26の円錐台形上端部28、31により絞り作用を受けるため、それら円錐台形上端部28、31近傍に空気溜りが生じ、その空気溜りからの冷却用空気が両流入孔29、32を経て第1、第2副通路11、12を流通し、第1副通路11の冷却用空気は通気性担体37を通過して第2副通路12の冷却用空気と合流し、その後冷却用空気は流出孔41から流出路42に流込んでそこを流通する。

#### [0027]

この場合,円筒状フィルタ18の外周面全体が水素吸蔵放出面6であるから,単位容積当りの水素吸蔵放出面積が大となり,これにより単位容積当りの水素吸蔵量を増加させると共に水素吸蔵速度を向上させることができる。

#### [0028]

また各水素貯蔵ユニット7の粉末状水素貯蔵材HSMは、冷却用空気が流通する第1、第2主通路9、10、流出路42および広い伝熱面積を備えた加熱-冷却体8によって効率良く冷却され、これにより粉末状水素貯蔵材HSMにおける蓄熱が回避される。

#### [0029]

水素放出時には、図6に示すように第1主通路9に、その下端側から第5接続管59を介し燃焼用水素を供給してその通路9を流通させ、また第2主通路10に、その下端側から第6接続管60を介し酸素としての空気を供給してその通路10を流通させる。その際、燃焼用水素は第1管体25の円錐台形上端部28により絞り作用を受けるためその円錐台形上端部28近傍に水素溜りが生じ、その水素溜りからの燃焼用水素が両流入孔29を経て第1副通路11を流通する。一

方,空気は第2管体26の円錐台形上端部31により絞り作用を受けるためその 円錐台形上端部31近傍に空気溜りが生じ,その空気溜りからの空気が両流入孔 32を経て第2副通路12を流通する。

## [0030]

この場合、燃焼用水素の圧力を空気のそれよりも高めておくことにより、通気性担体37において白金触媒等の存在下、燃焼用水素と酸素との燃焼反応が発生する。これにより燃焼熱と加熱水蒸気が発生し、その加熱水蒸気は流出孔41を経て流出路42を流通する。

## [0031]

燃焼熱は広い伝熱面積を備えた加熱ー冷却体8を介して粉末状水素貯蔵材HSMに,また加熱水蒸気の熱は大径管33を介して粉末状水素貯蔵材HSMにそれぞれ伝達されて,その水素貯蔵材HSMが効率良く加熱され,これにより水素の放出が広い水素吸蔵放出面6より迅速に行われる。

## [0032]

前記のように、外筒体2と水素貯蔵モジュール4との間を水素通路3として、それら2、4を非接触状態に保持すると、水素吸蔵時および水素放出時における外筒体2および水素貯蔵モジュール4間の断熱性を高めることができる。また第1、第2主通路9、10を、相隣る両水素貯蔵ユニット7の積層と同時に、両第1管体25を相互に、また両第2管体26を相互にそれぞれ継ぎ合せることによって形成するので、それら主通路9、10の形成を容易に行うことができる。さらに各水素貯蔵ユニット7における水素吸蔵に伴う膨脹量は略均一であり、且つ外筒体2は水素貯蔵ユニット7から離間しているので、そのユニット7の膨脹に伴い外筒体2が変形する、といった不具合は生じない。

#### [0033]

図7,8は水素貯蔵タンク1の第2実施例を示す。この例では各水素貯蔵ユニット7において、その円筒体14内に、銅、Ni等の良好な熱伝導性を持つ材料より構成された複数のフィン62が、中空軸15から放射状に延びるように配置され、各フィン62は中空軸15および上、下端壁16,17にそれぞれ溶接等により接合されている。つまり、各フィン62は加熱-冷却体8に接触する。

#### [0034]

これらのフィン62は粉末状水素貯蔵材HSM内に埋込まれて、その水素貯蔵材HSMの冷却および加熱に寄与するだけでなく、円筒体14を補強し、また粉末状水素貯蔵材HSMの偏在を防止する。

#### [0035]

図9は水素貯蔵タンク1の第3実施例を示す。この例では、水素吸蔵量の増加 を図るべく、複数の水素貯蔵モジュール4が、耐圧性外筒体2内に最密充填構造 をとるように配置されている。

#### [0036]

図10は水素貯蔵タンク1の第4実施例を示す。この例では外筒体2および水素貯蔵モジュール4が横断面六角形に形成されている。このように外筒体2および水素貯蔵モジュール4の横断面形状には大きな自由度があるもので、特別な制限はない。

#### [0037]

なお,主通路を1つにして,そこに燃焼用混合ガスを流通させることも可能である。

#### [0038]

#### 【発明の効果】

本発明によれば前記のように構成することによって、単位容積当りの水素吸蔵量を増加し、また水素吸蔵効率を向上させ、さらに装置全体の水素吸蔵量の増減が簡単で、その上、水素の放出を迅速に行うことが可能であると共に構造の簡素化を図られた水素貯蔵タンクを提供することができる。

#### 【図面の簡単な説明】

#### 【図1】

要部を破断した水素貯蔵タンクの第1実施例の斜視図である。

## 【図2】

水素貯蔵タンクの第1実施例の要部縦断面図である。

#### 【図3】

図2の3-3線断面図である。

#### 【図4】

図2の4-4線断面図である。

【図5】

図2の5-5線断面図である。

【図6】

燃焼用水素,酸素および水蒸気の流れを示す,図2と同様の要部縦断面図である。

#### 【図7】

水素貯蔵タンクの第2実施例の要部縦断面図であって、図2に対応する。

【図8】

図7の8-8線断面図である。

【図9】

水素貯蔵タンクの第3実施例の説明図である。

## 【図10】

水素貯蔵タンクの第4実施例の横断面図であって、図4に対応する。

#### 【符号の説明】

- 1 ……・・・水素貯蔵タンク
- 3 ………水素通路
- 4 ………水素貯蔵モジュール
- 5 ………積層体
- 6 ………水素吸蔵放出面
- 7 ………水素貯蔵ユニット
- 8 ………加熱 冷却体
- 9 ………第1主通路
- 10……第2主通路
- 11……第1副通路
- 12……第2副通路
- 3 7 ……通気性担体

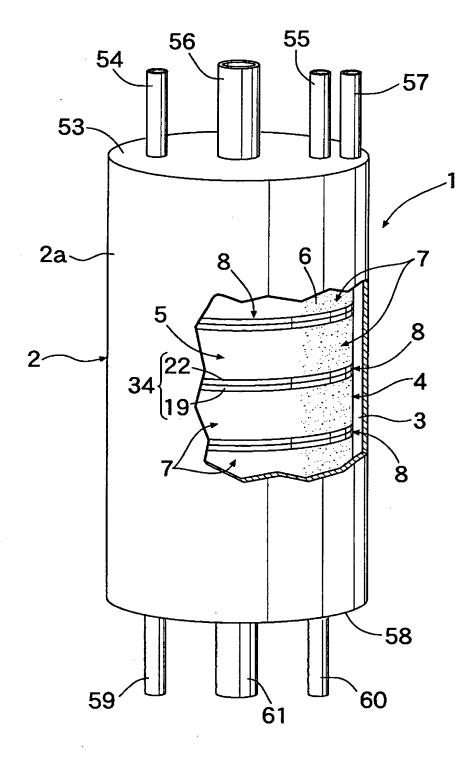
4 2 ……流出路

62……フィン

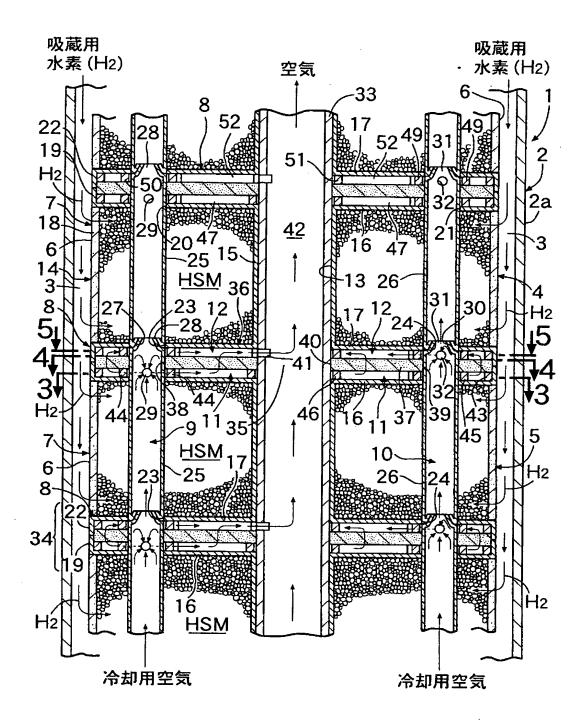
HSM……水素貯蔵材

【書類名】 図面

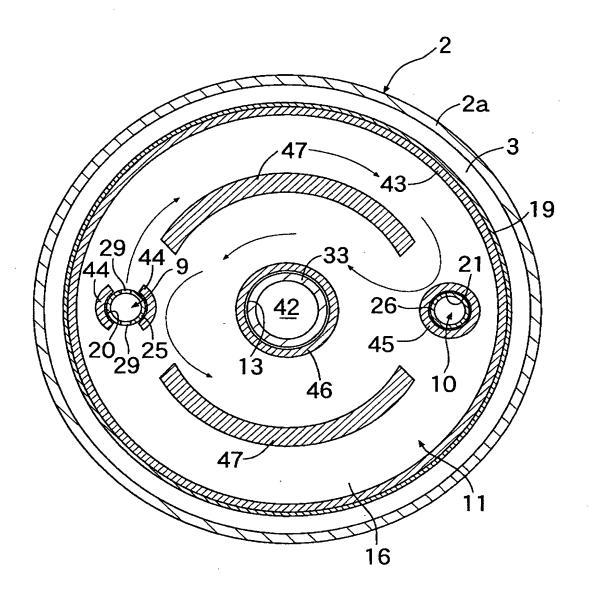
# 【図1】



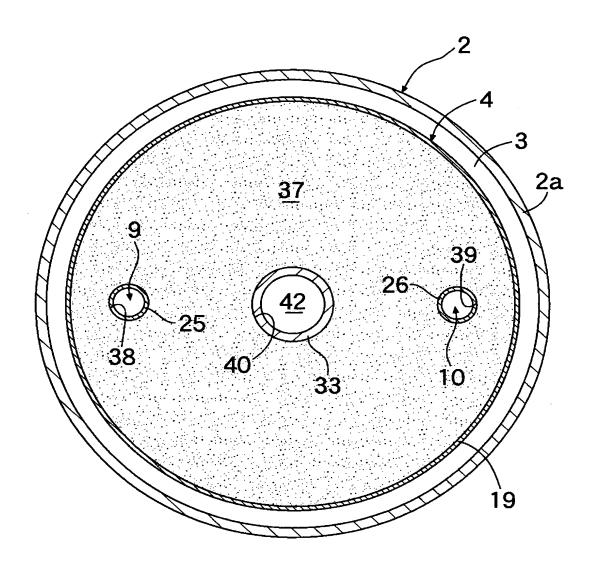
【図2】



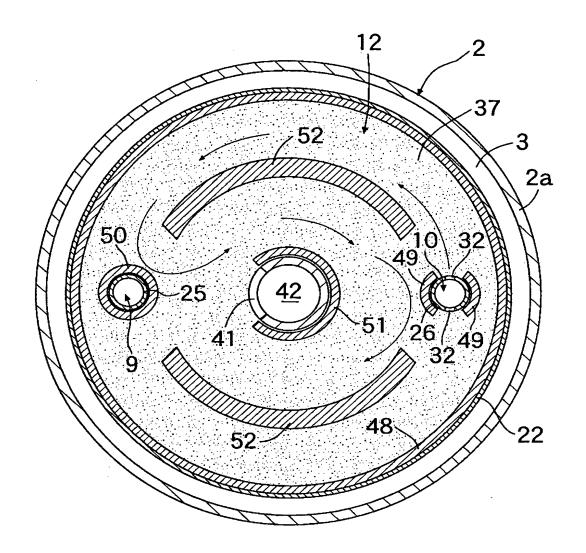
【図3】



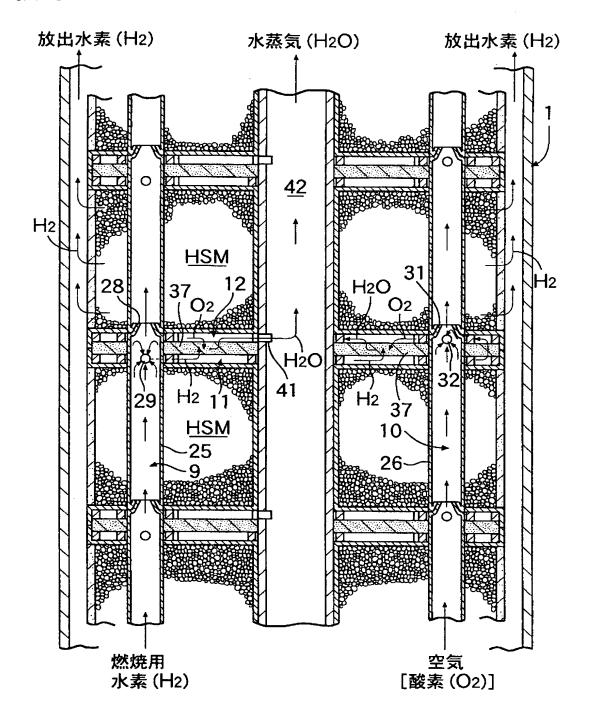
【図4】



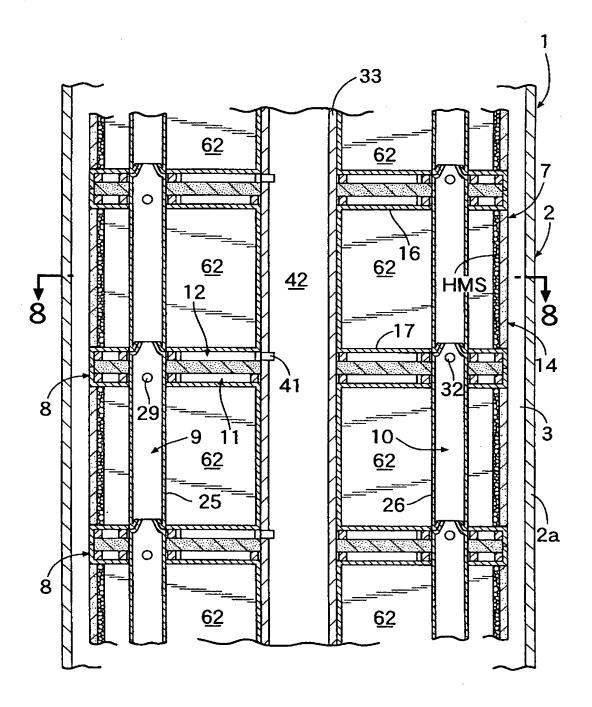
【図5】



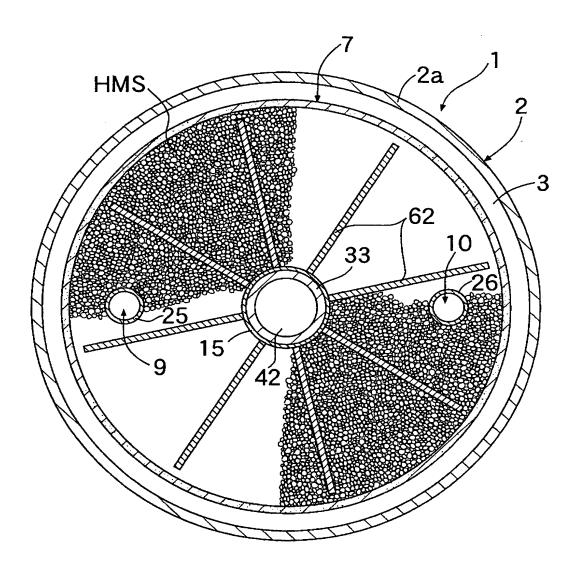
【図6】



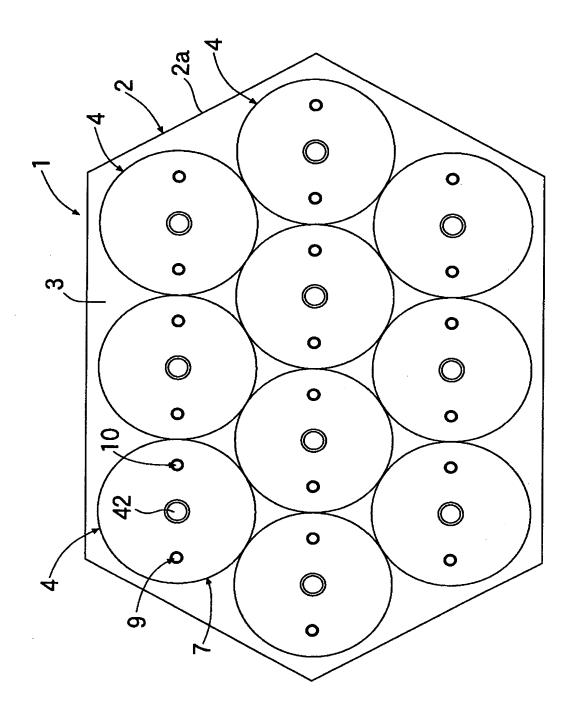
【図7】



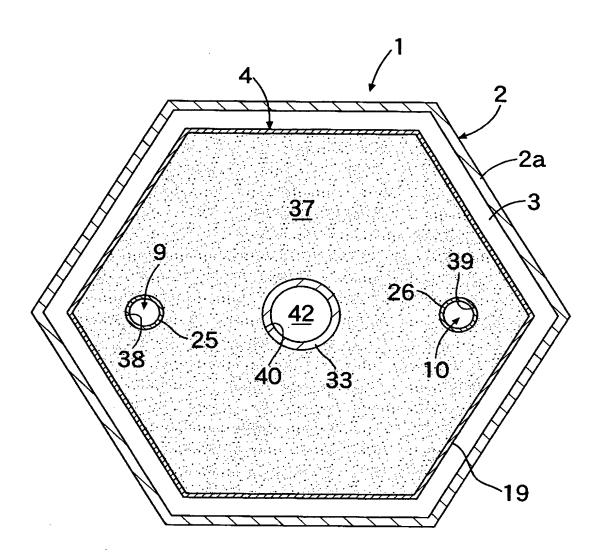
【図8】



【図9】



【図10】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 単位容積当りの水素吸蔵放出面積を大にして単位容積当りの水素吸蔵 量を増加させ、また水素の放出を迅速に行う。

【解決手段】 水素貯蔵タンク1は、外筒体2と、その外筒体2内周面との間に水素通路3となる間隔を存してその外筒体2内に収容された筒状水素貯蔵モジュール4とを備えている。水素貯蔵モジュール4は、粉末状水素貯蔵材HSMを充填されて外周面全体を水素吸蔵放出面6とした複数の水素貯蔵ユニット7を、相隣る両ユニット7間に加熱ー冷却体8を介在させて積層した積層体5と、その積層体5をユニット積層方向に貫通して加熱用流体および冷却用流体を流通させる第1、第2主通路9、10と、各主通路9、10から分岐して、各加熱ー冷却体8内に延びる第1、第2副通路11、12とを有する。

【選択図】 図2

# 認定・付加情報

特許出願の番号 特願2000-115822

受付番号 50005027231

書類名特許願

担当官 第四担当上席 0093

作成日 平成12年 4月12日

<認定情報・付加情報>

【提出日】 平成12年 4月11日

# 出願人履歴情報

識別番号

[000005326]

1. 変更年月日 1990年 9月 6日

[変更理由] 新規登録

住 所 東京都港区南青山二丁目1番1号

氏 名 本田技研工業株式会社